

基板クリーニング装置

上下2本のブラシにて、異物を強力除去

生基板専用タイプ

特長

- よく使用されているINライン用ブラシ線径より太軸のブラシを採用 (φ0.06mm→φ0.15mm ブラシ線径で比較すると能力約6倍UP)
- 基板の両面を同時クリーニング
- INライン及びOFFラインに対応

基本仕様

搬送方向	右→左(左→右)
搬送基準	手前側
搬送高さ	900±25(mm)
対応基板寸法	W50~250mm*L100~330mm
基板厚み	0.5~2.0mm
設備サイズ	W380×L650×H1110
電源	AC100V AC200V(50/60Hz)
エア	0.5MPa

運転モード

INライン

パスモード

片面実装基板・ブラッシングを行わない時

ライン単動モード

投入側から排出側への1回動作

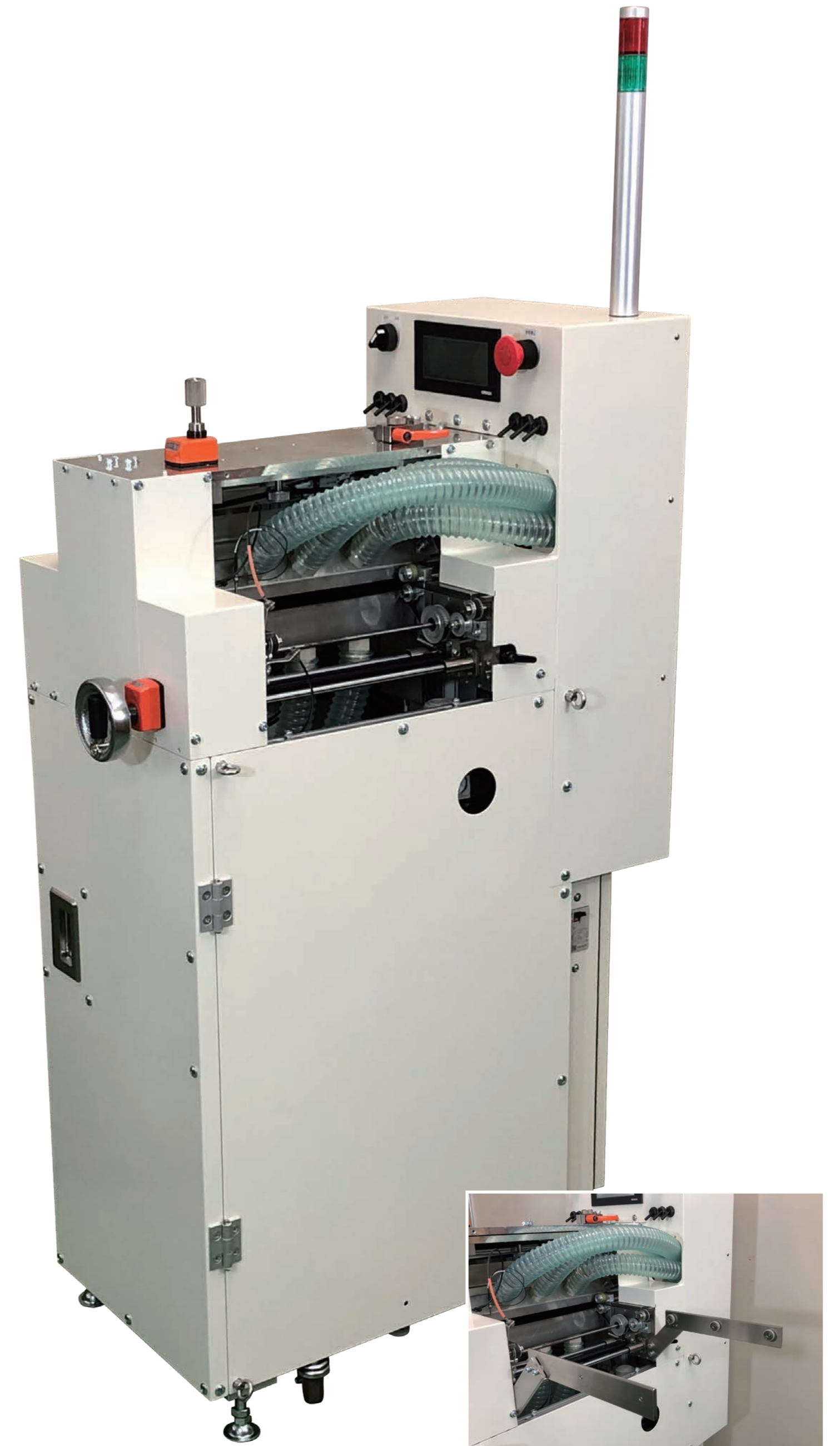
ライン復動モード

インラインにて往復ブラッシングを行うモード

OFFライン

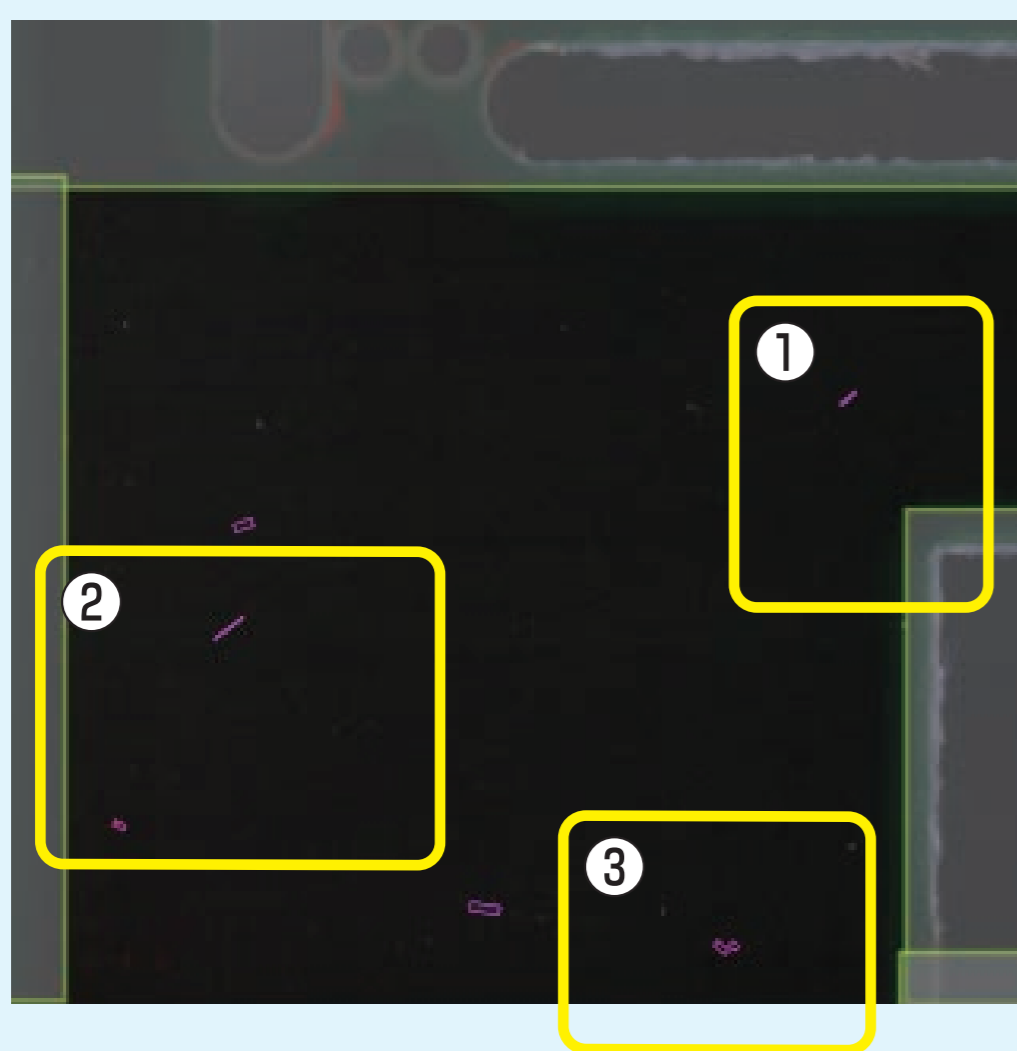
リターンモード

人での作業を前提としたモード。
リターン時もブラッシングを行う



ワーク支え装着時(オプション)

除去能力検証



検証条件

- 基板表面に基板クズを撒き、パッキング梱包時と同様に荷重をかける。
- 弊社クリーニング装置を使用し基板クリーニングを実施。
- OMRON社製 VT-S730HIにて基板クリーニング前後の異物の検査・測定を実施
※基板面より0.02mm以上の部分を測定

検証結果

- 3D検査機にて基板表面の異物は検出されませんでした。
- 異物付着していた箇所はクレーター状となり高さの違いを検出しました。

検証結果により、通常の異物付着や基板パッキング等による圧着異物の除去にも有効です。

お客様の御要望に対応したカスタマイズにも対応させていただきます。

新生電子株式会社

ファクトリーアイテムビジネスチーム